

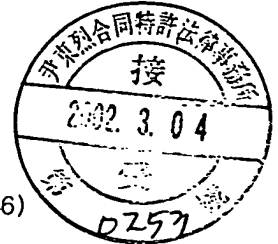
출력 일자: 2002/3/4

발송번호 : 9-5-2002-006831411  
발송일자 : 2002.02.28  
제출기일 : 2002.04.30

수신 : 서울 강남구 역삼1동 648-23 여삼빌딩 901  
호  
윤동열 귀하

135-748

## 특허청 의견제출통지서



출원인 명칭 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 (출원인코드: 519980960646)  
주소 일본국 교토후 나가오카교시 덴진 2초메 26방 10고

대리인 성명 윤동열 외 1 명  
주소 서울 강남구 역삼1동 648-23 여삼빌딩 901호

출원번호 10-2000-0016865

발명의 명칭 세라믹 그린 시트를 가공하는 방법 및 그것을 가공하는 장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

이 출원의 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

### [아래]

1. 본 발명의 청구범위 전항은 명세서 및 도면의 기재로 보아, 세라믹 그린 시트 가공에 관한 것으로, 회절격자를 이용하여 레이저빔을 복수로 분광하여 조사함을 특징으로 하나, 이는 인용참증1, 일본공개특허공보 10-34365 (1998.02.10)의 청구범위와 실시예(도1)에 공지된, 위상격자를 이용한 레이저 미세 천공 기술내용 및 인용참증2, 일본공개특허공보 8-33993 (1996.02.06)의 청구범위와 실시예(도1~도3)에 공지된, 위상격자를 이용한 레이저 가공 장치 기술내용과 유사하여 당업자간에 용이하게 발명될 수 있는 것으로 판단됩니다.

### [첨부]

첨부 1 인용참증1

첨부2 인용참증2 끝.

2002.02.28

특허청

심사4국

반도체1 심사담당관실

심사관 박준영



출력 일자: 2002/3/4

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-5729 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터